



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22982X

Issue Date: 04 Dec 2019

Title of Change:	Qualification of copper wire for NCN8025AMNTXG and NCN8026AMNTXG products in QFN4040 package.							
Proposed First Ship date:	01 Aug 2020 or earlier if approved by customer							
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Shannon.Riggs@onsemi.com							
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.							
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>							
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Changed product will be identified by datecode.							
Change Category:	Assembly Change							
Change Sub-Category(s):	Material Change							
Sites Affected:								
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites							
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None							
Description and Purpose:								
This IPCN is to announce the intended qualification and conversion from gold to copper wire of the QFN4040 devices listed in the affected parts section below.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bond Wire</td> <td>B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)</td> <td>N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)</td> </tr> </tbody> </table>			Before Change Description	After Change Description	Bond Wire	B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)	N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)
	Before Change Description	After Change Description						
Bond Wire	B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)	N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)						
There are no planned marking changes as a result of this notification.								

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: NCN8025AMNTXG

RMS: 63676

PACKAGE: QFN4040

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	TA=125C JA108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 Hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150C	2016 Hrs
PC	J STD 020, JESD22-A113	IR reflow at 260C	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	192 Hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 500 cycles	500 cyc
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 Hrs
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	

Estimated date for qualification completion: 6 March 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NCN8025AMNTXG	NCN8025AMNTXG
NCN8026AMNTXG	NCN8025AMNTXG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22982X

発行日: 04 Dec 2019

変更件名:	QFN4040 パッケージの NCN8025AMNTXG および NCN8026AMNTXG 製品に銅ワイヤーの認定							
初回出荷予定日:	1 August 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Shannon.Riggs@onsemi.com> にお問い合わせください。							
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。							
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がございましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。							
変更部品の識別:	変更された製品は、日付コードによって識別されます。							
変更カテゴリ:	アセンブリの変更							
変更サブカテゴリ:	材料の変更							
影響を受ける拠点:								
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:							
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	なし							
説明および目的:	本 IPCN は、以下の影響を受ける部品セクションに記載されている QFN4040 製品の金ワイヤーから銅ワイヤーへの切り替えと認定の意向をお知らせするものです。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボンドワイヤー</td> <td>B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)</td> <td>N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)</td> </tr> </tbody> </table> 今回の通知に伴い予定されるマーキングの変更はありません。			変更前の表記	変更後の表記	ボンドワイヤー	B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)	N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)
	変更前の表記	変更後の表記						
ボンドワイヤー	B50607A076(1.0 mil Tanaka Gold Wire)	N40363E002 (1.0mil Tanaka TCA-1 Bare Cu Wire)						



認定計画:

デバイス名: NCN8025AMNTXG

RMS: 63676

パッケージ: QFN4040

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	TA=125C JA108	TA=125C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 Hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150C	2016 Hrs
PC	J STD 020, JESD22-A113	IR reflow at 260C	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max	192 Hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 500 cycles	500 cyc
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 Hrs
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	

認定完了予定日: 6 March 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
NCN8025AMNTXG	NCN8025AMNTXG
NCN8026AMNTXG	NCN8025AMNTXG